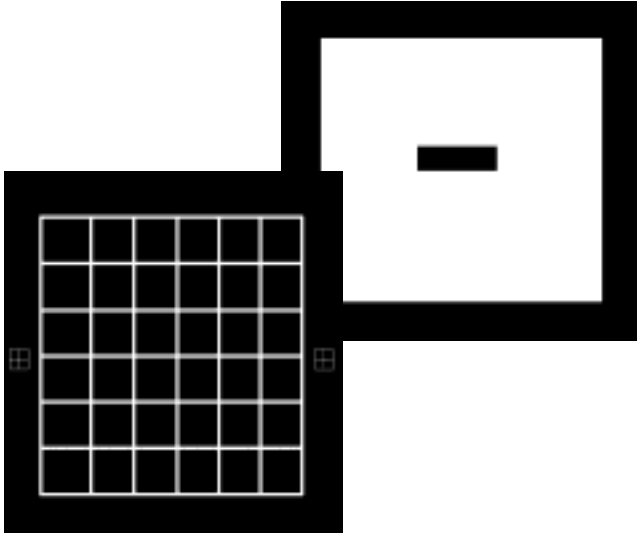


## Cleave Reticles

Q-Cleave レティクルは、フィールド中央でレジストおよびプロセスの特性解析に理想的です。



M-Cleave レティクルのパターンは、フィールド全体をカバーすることで、フォーカスや露光による全フィールドの Cleave を可能にしています。自動 SEM で、フィールド全体が要求される場合、このレティクルは極めて有用です。

### 特長

- クリーブを容易にする設計
- フォーカスや露光による全フィールドの Cleave が可能
- フィールド中央でのレジストやプロセスの評価
- クリーブ・データの評価に要する時間を削減
- 焦点深度の分析に有用
- コンタクトやラインは、全てのフィールド・サイズが可能
- カスタム デザインが可能
- ステップ・サイズは、等倍で 2 - 300 nm
- ライン・サイズは、193 nm リソグラフィ用
- クリアーとダーク・フィールドが可能
- OPC と位相シフトのバージョンが可能

### 用途

- 光源のユニフォーミティー
- レジスト解析
- ウェハー・チャック平坦度
- フィールドの傾斜/湾曲
- レジスト、プロセスの特性解析
- フォーカス
- 露光量
- 現像速度
- 寸法の均一性

Benchmark Technologies 社以下

Benchmark 社の Cleave レティクルは、SEM アプリケーションに Cleave 可能パターンを提供するための設計になっています。Cleave レティクルは、クリープ済みウェーハからのデータの特性解析に要する時間を大幅に削減します。

### M-Cleave Reticle

M-Cleave レティクルのパターンは、フィールド全体をカバーすることで、フォーカスや露光による全フィールドの Cleave を可能にしています。自動 SEM で、フィールド全体が要求される場合、このレティクルは極めて有用です。レンズを 6 箇所定位させることで、フォーカスまたは露光によるフィールド全体のマイクロステップが 20 回まで可能です。水平または垂直のステップにより、エッジ全体またはフィールドの中央を 1 回の簡単なステップでクリープさせます。

### Q-Cleave Reticle

Benchmark 社の Q-Cleave レティクルは、Cleave 可能パターンを SEM アプリケーションに提供します。このレティクルは、大領域のクリープ配列を可能にし、フィールド中央またはレジストおよびプロセスの特性解析に理想的です。